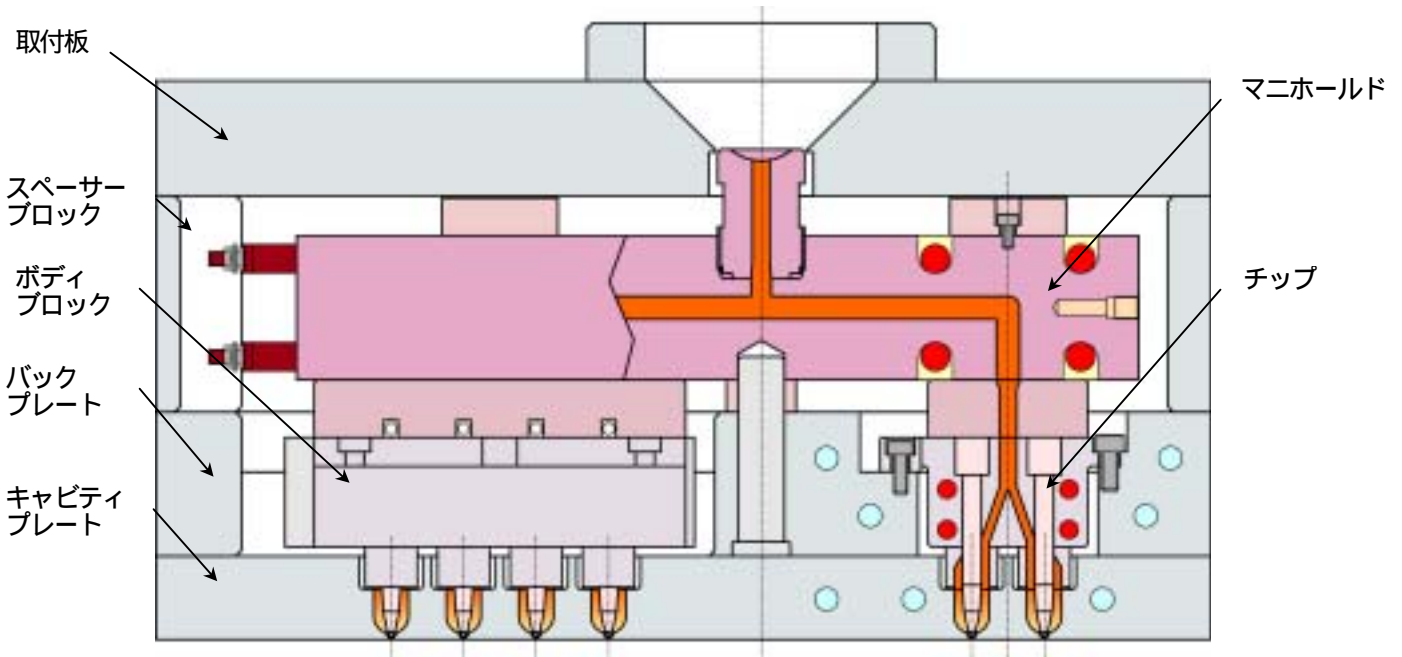
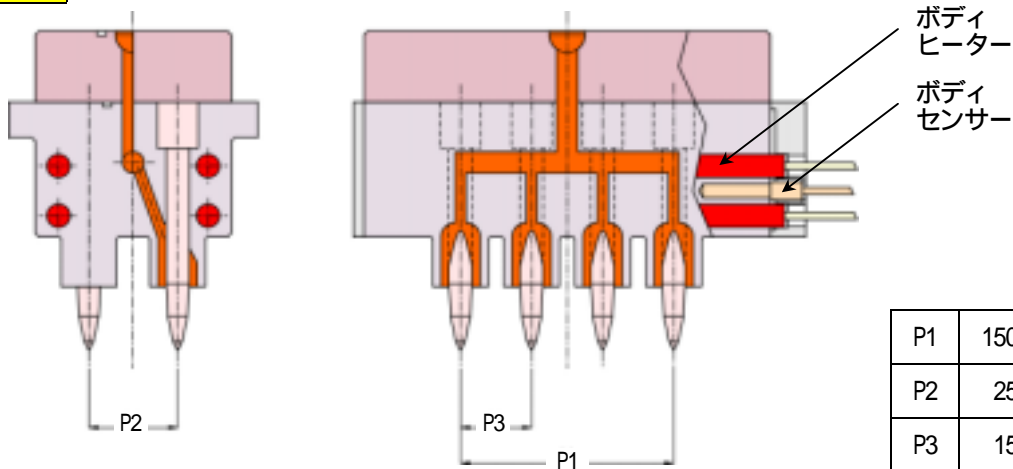


Iシリーズ 超小物成形品対応スピアシステム

ホットランナーシステムの構造



商品外観図



P1	150mm (MAX)
P2	25mm ~ 50mm
P3	15mm ~ 30mm

特徴

1. 信頼の構造

極限のコンパクト構造を駆使し、システム内の樹脂量が約 1/10 に減少 (当社比) 小物多数個取り HR 化の課題である滞留による樹脂焼け・分解などの問題を構造面からクリアにしました。

2. 安定した温度特性

ボディブロックにチップが包まれる構造により、優れた温度特性を発揮します。チップヒーターによるゲート部のコントロールも可能で汎用樹脂はもとより汎用エンブラ樹脂まで対応可能です。

3. 容易な精密制御

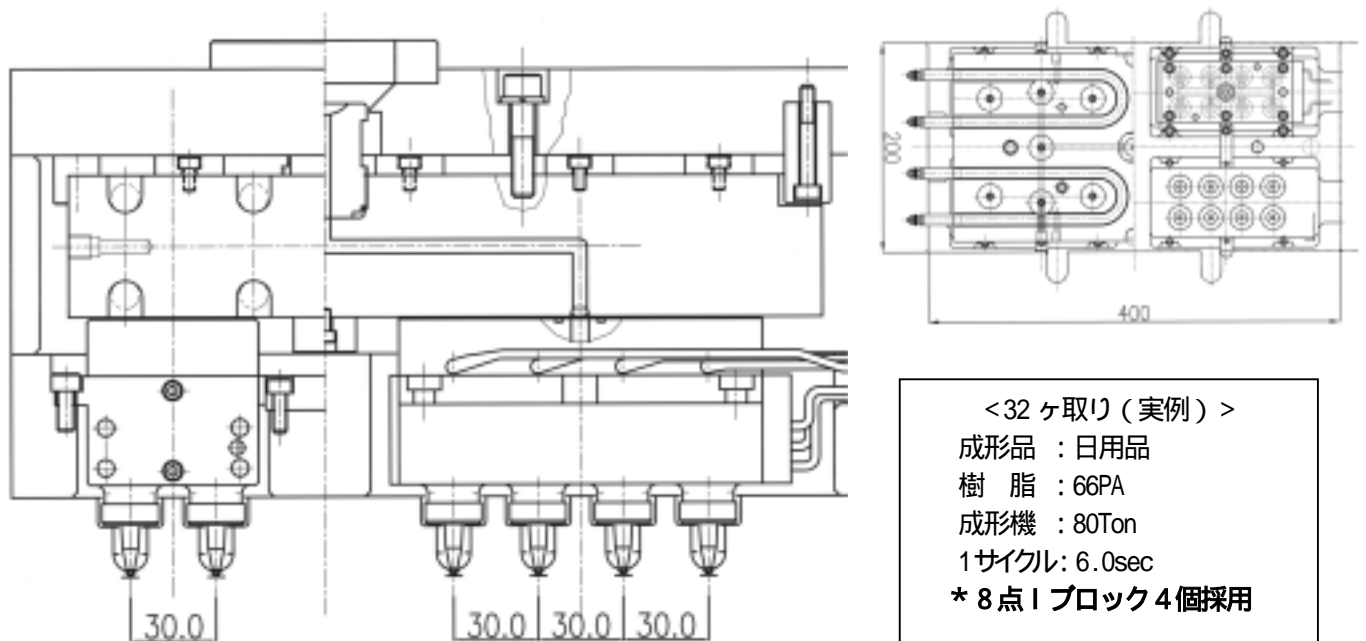
ボディ制御はブロック毎の温度制御、チップは 1 チップ毎の出力制御で条件設定調整ができます。

仕様

1. ボディヒーター : 200V ~ 240V (AC)
2. チップヒーター : 8V (AC)
3. コントローラー : 専用 AXC-NP コントローラー (専用コントローラー以外のご使用は原則出来ません。)

1シリーズ 超小物成形品対応スピアシステム

参考マニホールド図面



実績表

樹脂	製品重量(g)	キャビ×ゲート	ゲート径(mm)	用途
PP	0.3	32×32	0.6	パッキン
PP	0.3	96×96	0.6	保護キャップ
PP	0.3	12×12	0.7	ジョイント
PP	0.7	64×64	0.5	保護キャップ
PP	0.7	120×120	0.6	保護キャップ
PE	0.4	32×32	0.6	プランジャ
PE	1.0	16×16	0.6	カップ
PS	0.3	32×32	0.5	キャップ
PS	0.8	24×24	0.5	日用品
AS	0.4	64×64	0.6	部品
PMMA	0.7	16×16	0.4	レンズ
66PA	0.2	32×32	0.6	ガスケット
66PA	0.5	32×32	0.6	ガスケット
POM	0.4	12×12	0.8	機構部品
POM	0.5	16×16	0.8	AV部品
PBT	0.6	16×16	0.8	電子部品